

주요기업·경영진 국감 증인 채택 담합·기업회생 등 책임공방 예고

쿠광 등 개인정보 유출 사태 조사
TV홈쇼핑 재승인 실효성 도마 위
홈플러스 파산 위기 관련 소환도

10월 국정감사를 앞두고 유통업체가 긴장하고 있다. 개인정보 유출과 담합 의혹부터 홈플러스 기업회생 사태, 플랫폼 거래 관행, TV홈쇼핑 재승인 제도까지 업계 주요 현안이 여러 상임위원회에서 다뤄질 예정이다. 주요 유통기업과 경영진이 잇따라 증인으로 채택되면서 각종 논란과 현안을 둘러싼 책임 공방이 이어질 전망이다.

28일 〈메트로경제신문〉 취재에 따르면 다음달 6일부터 27일까지 3주간 국정감사가 진행될 예정이다. 유통기업이 소환된 국정감사 일정은 과학기술정보방송통신위원회·농림축산식품해양수산위원회·산업통상자원중소벤처기업위원회 등이다.

과기정통위원회에서는 개인정보 유출과 관련한 조사를 위해 우아한형제들과 쿠팡이, TV홈쇼핑 재승인 제도의 실효성에 관한 논의를 위해 GS리테일과 롯데홈쇼핑이 소환될 예정이다.

우아한형제들은 지난 3월 고객 상담 외주업체가 고객 개인정보를 조화·유출해 최소 30건의 보복 테러가 발생한 바 있다. 개인정보가 유출된 것은 물론 실제 피해까지 발생하면서 당시 큰 논란

을 일으켰다. 쿠팡은 지난해 3750만명의 개인정보 유출에 따른 과징금 불복 문제에 더해 공정거래위원회 현장조사 거부까지 전방위로 국감에 오를 것으로 보인다.

TV홈쇼핑 업계는 재승인 제도의 실효성과 중소 납품업체 보호를 위한 거래 관행·상생협력 이행 실태와 관련해 국감에 불려나온다. GS리테일과 롯데홈쇼핑이 증인으로 채택됐다. 올해 재승인 조건에는 판매수수료와 연계된 서비스의 계약상 근거를 명확히 하고, 송출수수료 상승에 따른 부담을 납품업체에 전가하지 않도록 하는 내용이 포함됐다. 국감에서는 홈쇼핑사가 영업 현장에서 이 같은 요구 사항을 제대로 이행하고 있는지가 쟁점이 될 전망이다.

농축산위원회는 설탕값 담합 등 부당 거래행위 의혹에 대한 조사를 위해 CJ제일제당·삼양사·롯데칠성을 소환한다. 이들 기업은 올해에만 15조원에 육박하는 규모의 담합으로 매출의 12%에 해당하는 과징금을 부과받았다. 정부가 주요 원재료 수입 시 할당관세 0%를 적용했음에도 제품 가격을 낮추는 대신 독과점 담합 카르텔을 형성해 폭리를 취했다는 의혹이다.

홈플러스 파산 위기 사태를 들여다보기 위한 조사도 이뤄질 예정이다. 산자위 국감에서는 홈플러스 기업회생 과정에서 발생한 입점 소상공인 피해와 경영 정상

화 방안 등을 주요 주제로 김병주 MBK파트너스 회장과 김광일 홈플러스 대표(MBK부회장)를 증인으로 채택했다. 정무위원회에서도 MBK파트너스 관계자 소환을 검토 중인 것으로 알려졌다.

홈플러스는 MBK파트너스가 2015년 대규모 차입매수를 통해 인수한 이후 수익 극대화를 위한 과도한 리스부채와 자산 매각, 배당 등으로 재무 건전성이 악화됐다는 논란에 휩싸여 있다. 여기에 회생 절차를 밟는 과정에서 대주주 MBK파트너스의 책임 문제와 휴업 및 점포 폐점에 따른 입점 소상공인 피해 등이 함께 다뤄질 전망이다.

현재 확정되지 않은 증인도 있다. 우아한형제들은 산자위에서도 증인으로 거론되고 있으나 현재 채택되지는 않은 상태다.

업계에서는 배달앱 기업이 입점업체 최대우의 의혹과 중개·배달수수료 관련 문제를 추궁받을 것으로 보고 있다. 최근 배달의민족과 쿠팡이츠가 경쟁 플랫폼과 비교해 가격이나 거래조건에서 동등하거나 유리한 수준을 적용하도록 입점업체에 요구했다는 의혹은 현재 공정위 심의 대상에 올라 있다. 여기에 배달앱의 수수료 체계와 입점업체의 가격 결정에 플랫폼이 미치는 영향도 주요 쟁점이 될 전망이다.

/김서현 기자

seoh@metroseoul.co.kr



metro

삼성 동행노조, 손용호·안영득 지도부 선출

초기업노조 공동교섭 입장 엇갈려

삼성전자 가전·스마트폰 등을 담당하는 디바이스경협(DX) 부문 중심의 동행노조가 새 지도부를 출범시키면서 DX 보상 확대가 내년 임금협상의 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 새 지도부는 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문과의 공동교섭을 통해 성과급 격차 해소에 나설 방침이다. 다만 DS 중심의 초기업노조가 독자 교섭을 택하면서 보상과 교섭 방식을 둘러싼 노사·노노 갈등이 본격화할 전망이다.

28일 동행노조에 따르면 이날 차기 위원장·수석부위원장 선거에서 손용호·안영득 후보가 9777표를 얻어 54.2%의 득표율로 당선됐다. 지난 21일부터 이날 오전 9시까지 진행된 선거에는 조합원 62.1%가 참여했다.

새 지도부의 첫 과제는 내년 임금협상이다. 동행노조는 임금·단체협약 태스크포스(TF)를 가동해 DX의 요구안을 마련하고 DS와 함께 협상할 수 있는 공동교섭 구조를 회사에 요구할 계획이다.

동행노조가 공동교섭을 요구하는 배경에는 DX와 DS 간 성과급 격차가 있다. 올해 임금협상에서 DS에는 영업이익의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급이 신설됐다. 반면 DX와 CSS사업팀은 특별경영성과급 대상에서 제외되고 1인당 600만원 상당의 자사주를



삼성전자 동행노동조합 조합원들이 21일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 인근에서 열린 집회에 참석하고 있다. /차현정 기자

받았다.

DS 특별경영성과급이 지급되면 보상 차이는 더 벌어질 수 있다. 재원의 40%는 DS 구성원에게 공통 배분하고 나머지 60%는 사업부별 성과에 따라 차등 지급한다. 기존 초과이익성과급(OPI)도 유지돼 메모리와 파운드리·시스템·LSI 등 사업부의 실적에 따라 실제 수령액이 달라질 수 있다.

다만 공동교섭을 놓고 노조 간 입장은 엇갈린다. DS 중심의 초기업노조는 지난 달 동행노조에 2027년 임금협상에서 공동교섭단을 구성하지 않겠다고 통보했다. 교섭장구 단일화 절차에 따라 협상하되 DX의 요구를 별도로 반영하려면 교섭단위 분리를 검토하라는 입장이다.



/구남영 기자 koogija_tea@

metro

공정위, 명륜당 법인·이종근 회장 고발

회장 일가 소유 대부업체 부당 자금 지원
가맹점 고리 대출… 수백억대 이익 챙겨

유명 숯불돼지갈비 프랜차이즈 '명륜진사갈비'의 가맹본부 명륜당이 회장 일가가 소유한 14개 대부업체에 3000억 원에 달하는 자금을 저리로 빌려주고, 가맹점주에게는 고리 대출 장사를 벌여 이익을 챙긴 사실이 적발됐다.

공정거래위원회는 명륜당이 회장 일가 소유 대부업체에 총 2983억 원의 자금을 부당 지원한 행위와 가맹희망자에게 특수관계를 은폐하고 허위 정보를 제공한 행위에 대해 시정명령과 함께 과징금 총 148억 7200만 원(부당지원 104억 7,200만 원, 허위·기만 정보제공 44억 원)을 부과하고, 명륜당 법인과 이종근 회장을 검찰에 고발하기로 결정했다고 28일 밝혔다.

이순미 공정위 상임위원은 이날 브리핑에서 “명륜당은 14개 대부업체에게 2021년 12월부터 2026년 4월까지 4년 3개월 동안 정상적인 자금조달 금리보다 현저히 낮은 연 2.3% 또는 연 4.6%의 저리

로 총 2983억 원의 자금을 대어줬고, 그 결과 대부업체들이 조달비용 절감에 따라 얻게 될 경제상 이익은 약 217억 원에 달한다”고 밝혔다.

조사 결과 이종근 회장은 1명 남짓한 공유오피스에 주소지만 둔 폐이퍼컴퍼니 형태의 대부업체 14곳을 설립한 뒤, 명륜당에서 2~4%대 저리로 조달받은 자금을 활용해 가맹점주들에게 연 12~18%의 고금리로 창업·리모델링 자금을 대출해 줬다. 공정위는 대부업체에 빌려준 자금에는 명륜당이 산업은행 등으로부터 연 3~4%대 저리로 지원받은 790억원의 정책자금도 포함된 것으로 봤다.

이순미 상임위원은 “산업은행으로부터 받았던 금액을 그대로 대출금에 활용했느냐는 부분은 단정하기 어렵다”면서도 “현금성 자산이 40억~120억원인데 대부업체로 가는 대출금액은 계속 상당한 규모로 나간 상황을 봤을 때 결과적으로 저리로 받은 정책자금이 그렇게 활용됐을 것으로 보인다”고 설명했다.

/세종=한용수 기자 hys@



metro

SK하이닉스-TSMC, HBM 등 협력 확대

‘TSMC OIP 콘퍼런스’ 참가
차세대 메모리 포트폴리오 공유

SK하이닉스가 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 TSMC와 차세대 고대역폭메모리(HBM)와 첨단 패키징 분야에서 협력을 확대한다. HBM5 검증부터 차세대솔리드스테이트드라이브(SSD)까지 인공지능(AI) 인프라 전반을 겨냥한 메모리 기술 개발에 속도를 내는 모습이다.

SK하이닉스는 지난 23일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라에서 열린 ‘TSMC 오픈 이노베이션 플랫폼(OIP) 콘퍼런스’에 참가해 차세대 메모리 포트폴리오와 개발 전략을 공유했다고 28일 밝혔다.

OIP는 TSMC가 반도체 생태계 기업들과 기술 개발과 협업을 위해 운영하는 개방형 혁신 플랫폼이다. SK하이닉스는 2024년부터 행사에 참가해 AI 메모리 기술을 소개하고 있다.

이번 행사에서 SK하이닉스는 TSMC의 ‘3DFabric-HBM Integration’ 분야 ‘올해의 파트너상’을 2년 연속 수상했다. 양사는 TSMC의 2.5차원(D) 3D 패키징 기술인 CoWoS를 기반으로 차세대 HBM5를 검증한 협업 성과를 인정받았다. CoWoS는 GPU와 여러 개의 HBM을 서로 가깝게 배치하고 연결해 하나의 고성능 반도체처럼 작동하도록 만드는 기술이다.

HBM 성능이 높아질수록 GPU 등 로



SK하이닉스 ‘TSMC 오픈 이노베이션 플랫폼 콘퍼런스’ 전시 부스. /SK하이닉스

직 반도체와 메모리를 하나의 시스템으로 구현하는 첨단 패키징 기술의 중요성도 커지고 있다. SK하이닉스와 TSMC는 제품 개발 초기 단계부터 HBM과 패키징 간 연계 검증을 진행하며 차세대 AI 시스템 위한 협력을 이어가고 있다.

SK하이닉스는 행사에서 엔비디아의 차세대 AI 슈퍼칩 ‘베라 루빈’에 탑재되는 HBM4 36기가바이트(GB) 12단과 96GB 소켓2(SOCAMM2)도 공개했다. HBM4는 루빈 GPU 주변에 탑재돼 대규모 연산에 필요한 데이터 전송을 담당하고, 저전력 D램 기반 AI 서버용 메모리 모듈인 소켓2는 베라 CPU의 시스템 메모리로 활용된다.

차세대 제품으로는 HBM4E 48GB 12단과 HBM4 48GB 16단, 192GB 소켓2 등을 함께 선보였다. 서버 D램에서는 256GB 3DS RDIMM과 128GB MRDIMM, 10나노급 6세대(1c) 공정을 적용한 64GB

RDIMM 등을 공개했다.

AI 데이터센터 수요 확대에 대응한 기업용 SSD(eSSD) 전략도 제시했다. SK하이닉스는 PCIe 기반 eSSD 시장이 올해 509억달러(EB)에서 2030년 1933EB로 약 3.8배 성장할 것으로 전망했다. 이에 PCIe6·7세대 제품에서는 기존 단일 칩 컨트롤러를 기능별 칩셋으로 나눠 연결하는 차세대 SSD 설루션을 준비하고 있다. 이를 통해 개발 기간을 단축하고 용량 확장과 전력 효율 개선에 대응한다는 구상이다.

SK하이닉스는 “이번 OIP 콘퍼런스에서 2년 연속 올해의 파트너상을 수상하며 TSMC와 쌓아온 협력의 성과를 다시 한번 확인했다”며 “앞으로도 다양한 파트너들과 긴밀히 협업하며 AI 시대가 요구하는 메모리 설루션을 함께 만들어 나가겠다”고 말했다. /차현정 기자 hyeon@



metro